

Индивидуальная Конструкция Ручки Для Химически Стойкой Корзины-Цветка И Держателя Пластин Из Птфэ Для Очистки Полупроводников

Артикул: PL-CP166



введение

Максимизируйте выход полупроводниковой продукции с помощью индивидуальных держателей пластин и корзин-цветов из ПТФЭ. Разработанные для превосходной стойкости к плавиковой кислоте и агрессивным реагентам, эти системы для высокочистого манипулирования оснащены эргономичными ручками и прецизионными пазами, обработанными на станке с ЧПУ, для безопасной, бесконтактной очистки в мокрых процессах.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Процессы очистки RCA	Последовательная очистка с использованием растворов SC-1 и SC-2 для удаления органических остатков и металлических загрязнений.	Устойчив к высокому pH и окислительному стрессу без выщелачивания примесей в ванну.
Травление плавиковой кислотой	Удаление естественных оксидных слоев или сапфировых стеклянных слоев с кремниевых пластин с использованием концентрированной HF.	Полная устойчивость к HF, которая в противном случае растворяет стекло или разрушает стандартные пластмассы.
Травление / удаление пиранией	Удаление сильных органических загрязнений или фоторезиста с использованием смеси серной кислоты и перекиси водорода.	Сохраняет структурную целостность при высоких экзотермических температурах, генерируемых пирания-растворами.
Проявление в фотолитографии	Погружение пластин в растворы проявителя для определения схемы цепей после УФ-облучения.	Прецизионные пазы обеспечивают равномерное воздействие проявителя на поверхность пластины.
Промывка после ХМП	Высококачественная промывка после химико-механической полировки для удаления частиц суспензии.	Антипригарная поверхность предотвращает накопление суспензии и способствует быстрой и полной дезактивации.
Производство сложных полупроводников	Обработка пластин GaAs, InP или SiC для высокочастотной электроники и производства светодиодов.	Мягкие характеристики обращения предотвращают растрескивание более хрупких сложных материалов.
Ультразвуковая / мегасонная очистка	Поддержка пластин во время высокочастотной акустической очистки для удаления субмикронных частиц.	Отличное демпфирование вибраций и химическая стабильность под действием акустических кавитационных сил.

Категория спецификации	Детали параметров для PL-CP166	Варианты настройки
Основной материал	Высококачественный первичный ПТФЭ (политетрафторэтилен)	Опционально ПФА для улучшенной прозрачности/чистоты
Совместимость с размером пластин	4 дюйма (100 мм), 6 дюймов (150 мм), 8 дюймов (200 мм)	Доступны нестандартные диаметры и формы
Конфигурация пазов	Прецизионно вырезанные V-образные или U-образные профили	Настраиваемый шаг, глубина и угловое расстояние пазов
Вместимость	Стандартные конфигурации на 25 или 50 пластин	Индивидуальные размеры партий от одной пластины до больших объемов

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Категория спецификации	Детали параметров для PL-CP166	Варианты настройки
Дизайн ручки	Интегрированная верхняя или боковая ручка	Съемные, удлиненные или совместимые с автоматизацией ручки
Химическая стойкость	Полный спектр (кислоты, щелочи, растворители, окислители)	Проверено для HF, H2SO4, HNO3, HCl, NH4OH и т.д.
Рабочая температура	-200°C до +260°C	Адаптировано для конкретных профилей термического цикла
Метод изготовления	Сквозная индивидуальная обработка на станке с ЧПУ	Прецизионный контроль допусков для автоматизированного интерфейса
Протокол очистки	Очищено в чистых помещениях и запаковано в вакуум	Специализированная предварительная очистка для анализа следов